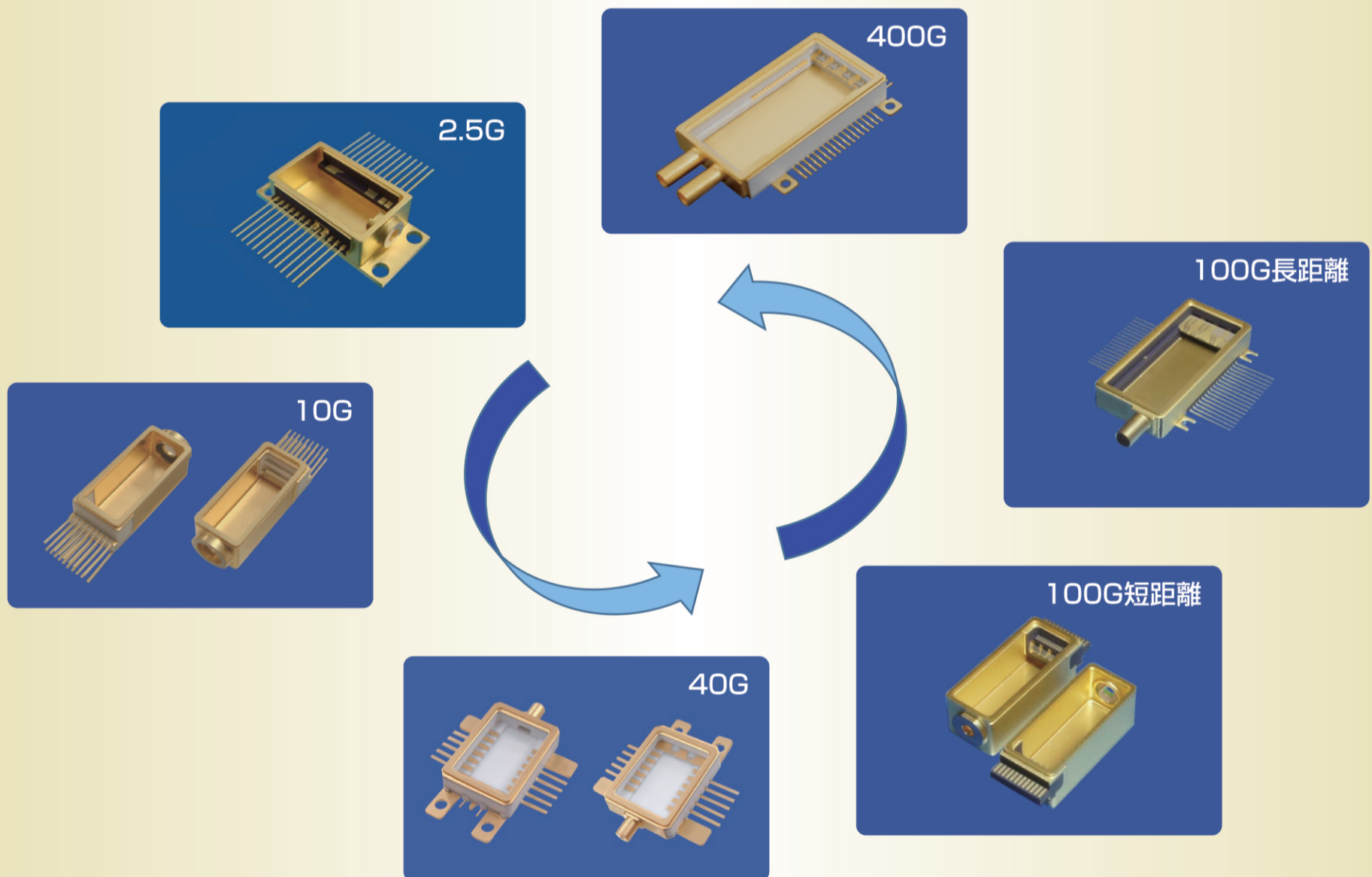


# 光半導体素子用パッケージの市場投入とセラミック材料技術の応用展開による光通信技術及び光通信産業への貢献



京セラ株式会社



セラミック多層技術を使用した封止技術を使用し、且つ高周波設計技術を織り込む事で2.4Gbps、10Gbps帯で使用されるSONET/SDH規格に正式採用されたのを皮切りにその後もETHERNET規格等光通信標準規格に正式採用され続ける等、長距離から短距離光通信全体の進歩発展に貢献できたと考えております。

現在では、次世代通信方式である400Gbps超 対応のPKGを供給しております。

## 特徴

- セラミックと金属の高温ロウ付けによる気密PKGを実現
- 高周波特性に優れたセラミック材料により高密度配線を実現
- 多積層配線により、優れたシールド性を実現
- SA窓の採用で高信頼性を実現

## 用途

- 高信頼性光通信用パッケージ
- LiDAR等の光学センサー用パッケージ